

各種線径(0.12mm~)のワイヤーが使用可能。

素線径・粒度の組み合わせで、様々なワークの切断に対応が可能。

■ 素線径・粒度ラインナップ

- ・素線径
  - ① 0.12mm
  - ② 0.16mm
  - ③ 0.25mm

素線径	0.12mm	0.16mm	0.25mm
耐久性	低い	↔	高い
カッティングロス	少ない	↔	多い

- ・粒度
  - ① 10-20 $\mu$ m(精度重視)
  - ② 30-40 $\mu$ m(標準)
  - ③ 40-60 $\mu$ m(粗加工)

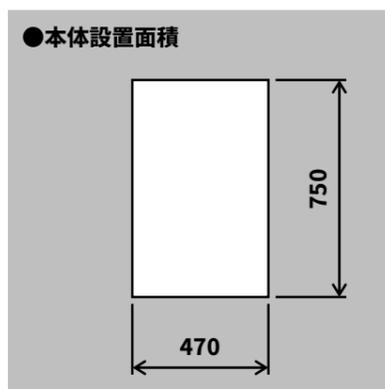
粒度	10-20 $\mu$ m	30-40 $\mu$ m	40-60 $\mu$ m
切断面粗さ	滑らか	↔	粗い
チッピング	小さい	↔	大きい

● 主な仕様

本機は、電着ダイヤモンドワイヤーを往復運動させて精密切断を行う卓上型ワイヤーソーです。低負荷切断に特化しており、セラミックス材料のチッピング、金属材料のバリを抑えた切断が可能。またワイヤーは一定の張力が働く機構を備えており、安定した切断を実現します。

電源	AC100V
切断方法	湿式/乾式
線速	5m~300m/min(無段変速)
線径	0.12mm~ 粒度10-20 $\mu$ m~
巻付量	約23m
ワークサイズ	W75×L75×H50mm
テーブルサイズ	W150×L100mm
ストローク	Max.180mm
送り機構	ウエイト送り機構(標準)
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防水カバーインターロック</li> <li>・非常停止ボタン</li> <li>・断線検知センサー</li> <li>・切断終了センサー</li> </ul>
ワイヤー交換	自動巻取り機能付き
機体寸法	W470×L650×H560mm
本体質量	約65kg
設置面積	W470×L750mm
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カメラ・モニターセット</li> <li>・テーブル自動送り機構</li> <li>・ゴニオメーター</li> <li>・ミリング用治具</li> </ul>

● 本体設置面積



クーラント装置(オプション)

点滴装置”点滴くん”

チューブポンプによる冷却水の供給をピンポイントで行う装置。



● 製品動画



左記のQRコードを読み取って、製品の詳細画面をご覧ください。スマートフォンやタブレットで簡単にアクセスできます。

Let's Make & Run Together

<https://www.maruto.com/>  
E-mail:maruto@maruto.com



本社/〒112-0003 東京都文京区春日 2-4-1  
TEL: 東京 (03) 6801-0727(代表) FAX: 東京 (03) 6801-2478  
福岡連絡事務所/〒815-0033 福岡市南区大橋 1-21-5 岩田ビル  
TEL: 福岡 (092) 512-2755 FAX: 福岡 (092) 561-4288

# 卓上型ワイヤーソー シングルワイヤーソー MW-400

軟質材料から硬質材料、脆性材料まで、乾式切断や貴重なサンプル、精密部品の加工も幅広く対応可能。



● 主な特長

自動巻取り機能搭載

ダイヤモンドワイヤーをキャプスタンに自動巻取り可能。

防水カバーインターロック

カバー開放時電動機動作不可。  
切断時カバー開放で非常停止。

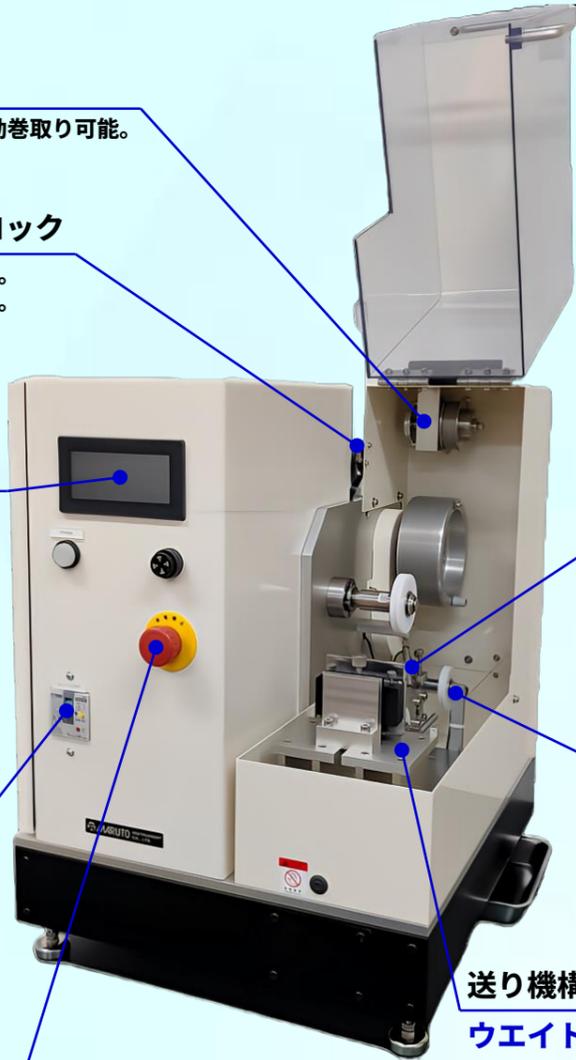
タッチパネル

視覚的に操作しやすいタッチパネルを採用。  
デジタル制御による数値設定が可能。



主電源

非常停止ボタン



断線検知センサー

ワイヤー断線を検知し非常停止。

切断終了センサー

切断終了を検知し自動停止。

送り機構

ウエイト送り機構(標準)

定圧切込で複合材や切断面積が変わるものなど、  
切断抵抗が変化する試料などに適しています。

テーブル自動送り機構(オプション)

モータによる定速送りで強制切込、  
低負荷切断などに適しています。

多彩な治具がラインナップ

① 標準治具

75mm角のマウント台を固定する治具。  
左右方向に切断位置を微調整する事が  
できます。



② 両押えバイス(オプション)

試料を両側クランプする治具。  
欠けやすい試料や脆い試料の破損を  
低減します。



③ ゴニオメーター(オプション)

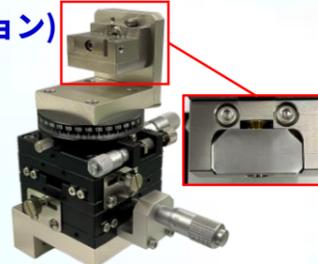
試料の傾斜(θX軸・θY軸)、水平回転(θ軸)、  
水平方向(X軸・Y軸)最大5軸を微調整可能な  
試料固定用治具。



※写真は4軸ゴニオメーターになります。

④ ミリング用治具(オプション)

イオンミリング装置用の試料台を  
そのまま装着できる治具。  
試料台に固定したサンプルの  
トリミングが可能。



※お客様の仕様に合わせた治具の設計・製作も承っております。

乾式切断に対応、なめらかな切断面が得られます。

■ 切断事例

モルタル(W160×L40×H40mm)

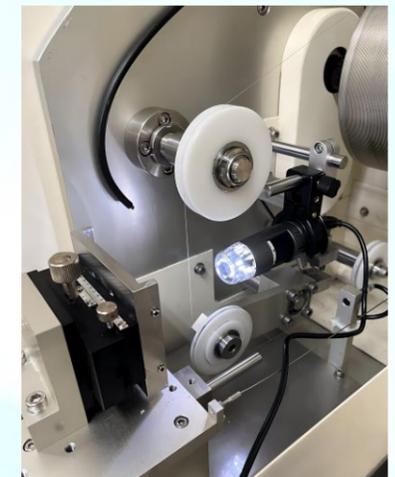
～切断条件～  
・線径:0.12mm  
・粒度:40-60μm  
・重り:300g  
・加工時間:60分



微小部品の切断及び正確な位置決めが可能。

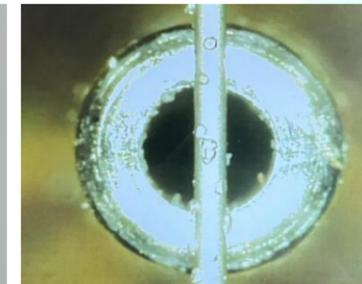
カメラ・モニターセット(オプション)

マイクログラフカメラとモニターディスプレイを搭載する事により、  
微小部品の切断及び正確な位置決めが可能。



シャープペンシル先端部品の切断

～切断条件～  
・線径:0.12mm  
・粒度:40-60μm  
・重り:200g  
・加工時間:5分



電子基板部品の切断

～切断条件～  
・線径:0.12mm  
・粒度:40-60μm  
・重り:200g  
・加工時間:5分

